

Cesto De Limpeza De Ptfе Para Semicondutores Suporte De Gravação A Úmido Para Wafers De 12 Polegadas Resistente A Ácidos E Alcalis Portador De Fluoropolímero

Número do item: PL-CP81



introdução

Projetado para ambientes de semicondutores de alta pureza, este cesto de limpeza de wafers de PTFE de 12 polegadas garante excepcional resistência química durante processos críticos de gravação a úmido e limpeza. O design fabricado sob medida fornece suporte confiável para o wafer e máxima exposição a fluidos para fabricação de precisão.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Limpeza RCA	Sequência padronizada (SC-1 e SC-2) para remoção de contaminantes orgânicos e impurezas metálicas.	Impede a recontaminação durante transições de pH alto e baixo.
Gravação HF	Remoção de camadas de óxido sacrificial ou óxidos nativos usando soluções de ácido fluorídrico.	A imunidade total ao ataque de HF garante a sobrevivência do equipamento a longo prazo.
Gravação Piranha	Mistura em alta temperatura de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio para remoção de fotoresiste.	Resiste a reações exotérmicas extremas sem amolecimento estrutural.
Enxágue Pós-CMP	Remoção de partículas de lama e produtos químicos após o Polimento Mecanoquímico (CMP).	Pontos de contato mínimos impedem o aprisionamento de partículas atrás do wafer.
Texturização de Célula Solar	Texturização ácida ou alcalina de wafers de silício de grande formato para melhorar a absorção de luz.	Durabilidade de alto volume em ambientes de exposição química contínua.
Fabricação MEMS	Gravação a úmido profunda de substratos de silício ou vidro para criar estruturas micromecânicas.	Garante taxas de gravação uniformes através da circulação de fluidos otimizada.
Fotolitografia	Revelação e remoção de materiais de fotoresiste usando solventes orgânicos especializados.	Material resistente a solventes impede a lixiviação de orgânicos no revelador.
Limpeza Megassônica	Limpeza acústica de alta frequência para remover partículas sub-micrônicas das superfícies dos wafers.	A densidade do material transmite efetivamente a energia acústica sem efeitos de amortecimento.

Recurso	Detalhe da Especificação (PL-CP81)
Material Principal	PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoretileno)
Compatibilidade de Diâmetro de Wafer	300mm (12 polegadas) - Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação
Configuração	Portador de wafer único / Configuração de cesto floral para múltiplos wafers
Processo de Fabricação	Usinagem de Precisão CNC / Fabricação Sob Medida
Resistência Química	Faixa completa (pH 0-14); resistente a HF, HNO3, HCl, H2SO4, KOH, etc.
Temperatura de Operação	Uso contínuo até 260°C (Limites personalizados com base no design)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Recurso	Detalhe da Especificação (PL-CP81)	
Passo/Espaçamento das Fendas	Totalmente personalizável para atender aos requisitos de fluxo de fluido ou capacidade	
Tipo de Contato	Designs de contato por ponto ou contato por borda disponíveis	
Opções de Alça	Interface fixa, removível ou flange automatizada para robôs	
Acabamento Superficial	Acabamento usinado ultrasuave para minimizar a adesão de partículas	
Padrão de Pureza	Conforme classe de semicondutor; análise de metais traço disponível	